

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 23 年 7 月 28 日 (2011.7.28)

【公開番号】特開 2009-242606 (P2009-242606A)

【公開日】平成 21 年 10 月 22 日 (2009.10.22)

【年通号数】公開・登録公報 2009-042

【出願番号】特願 2008-91251 (P2008-91251)

【国際特許分類】

C 0 9 J 133/04 (2006.01)

C 0 9 J 163/00 (2006.01)

C 0 9 J 183/04 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

【 F I 】

C 0 9 J 133/04

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 183/04

C 0 9 J 7/02 Z

H 0 1 L 21/52 E

H 0 1 L 21/52 C

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 6 月 15 日 (2011.6.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

アクリル重合体 (A) と、エポキシ樹脂 (B) と、熱硬化剤 (C) と、シリコン化合物 (D) とを含む粘接着剤組成物であって、

前記シリコン化合物 (D) が側鎖としてアラルキル基 (反応性有機官能基を除く) を有するオルガノポリシロキサンであって、かつ、25 における動粘度が 50 ~ 100, 000 mm²/sであることを特徴とする粘接着剤組成物。

【請求項 2】

前記熱硬化剤 (C) が、フェノール性水酸基および / またはアミノ基を有する熱硬化剤である請求項 1 に記載の粘接着剤組成物。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の粘接着剤組成物からなる粘接着剤層が、基材上に形成されてなる粘接着シート。

【請求項 4】

請求項 3 に記載の粘接着シートの粘接着剤層に半導体ウエハを貼着する工程と、該半導体ウエハをダイシングしてチップとする工程と、

該チップを、その裏面に前記粘接着剤層を転写させて前記粘接着シートの基材から剥離する工程と、

剥離されたチップをダイパッド部上に、該チップの裏面に転写された粘接着剤層を介して熱圧着する工程と

を含む半導体装置の製造方法。